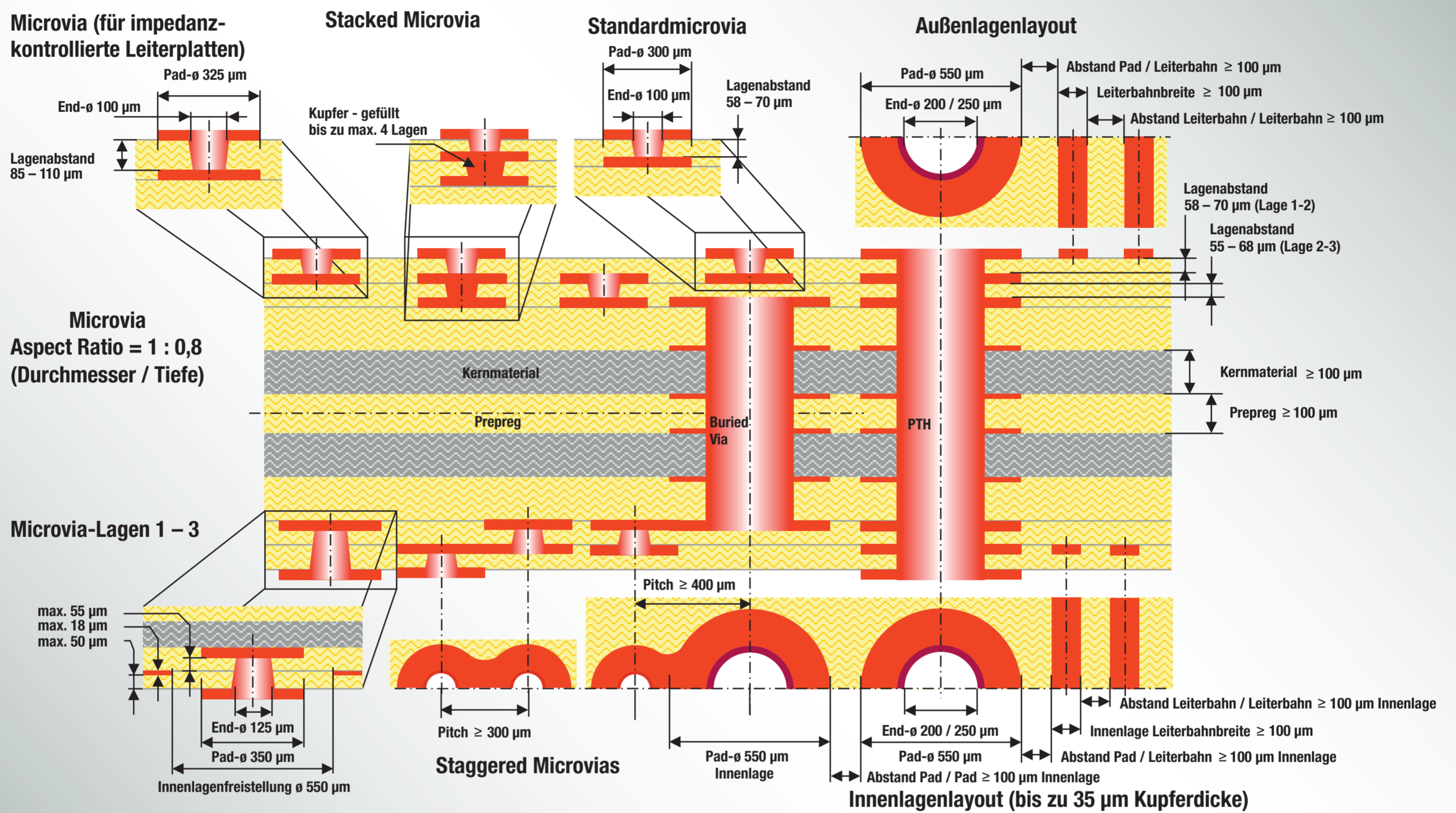


HDI Microvia Standard Design Guide



HDI Microvia Standard Design Regeln



BGA 0,80 mm Pitch

	Var. 1	Var. 2	Var. 3
BGA Lötpad	max. 400 μ m	-	max. 500 μ m
Lötstoppsmaskenfreistellung	50 μ m	\geq 50 μ m	50 μ m
Via Padgröße BGA Bereich	500 μ m	-	-
Microvia-Pad-Außenlagen	-	300 / 350 μ m	300 / 350 μ m
Microvia-Pad-Innenlagen	-	300 / 350 μ m	300 / 350 μ m
Leiterbahnbreite / -abstand Außenlagen	\geq 100 μ m	\geq 100 μ m	\geq 100 μ m
Leiterbahnbreite / -abstand Innenlagen	\geq 100 μ m	\geq 100 μ m	\geq 100 μ m

BGA 0,75 mm Pitch

Lötstoppsmaskenfreistellung 50 - 65 μ m
 Leiterbahnbreite 100 / 125 μ m
 BGA Pad- ϕ 350 μ m
 0,75 mm Pitch

BGA 0,65 mm Pitch

0,65 mm Pitch
 BGA Pad- ϕ 350 μ m
 Leiterbahnbreite 90 / 100 μ m
 Lötstoppsmaskenfreistellung 50 μ m

BGA 0,50 mm Pitch

	Var. 1	Var. 2	Var. 3
BGA Lötpad	300 - 330 μ m	240 μ m	275 μ m
Lötstoppsmaskenfreistellung	50 μ m	40 μ m	35 μ m
Microvia-Pad-Außenlagen	\geq 300 μ m	275 μ m	275 μ m
Microvia-Pad-Innenlagen	275 μ m	275 μ m	275 μ m
Leiterbahnbreite / -abstand Außenlagen	\geq 100 μ m	80 / 90 μ m	75 μ m
Leiterbahnbreite / -abstand Innenlagen	75 μ m	75 μ m	75 μ m

QFP 0,40 mm Pitch

Lötstoppsmaskensteg \geq 70 μ m
 Lötstoppsmaskenfreistellung 62 / 50 μ m
 Pad- ϕ 300 μ m
 Lötpad 200 μ m
 0,40 mm Pitch

BGA 0,40 mm Pitch

Lötstoppsmaskenfreistellung 35 μ m
 Lötpad- ϕ 275 μ m
 Leiterbahnbreite 100 μ m

Blau = Außenlage
 Grün = Lötstoppsmaske
 Rot = Lage 2
 Schwarz = Lage 3
 Violett = Lage 4